

※本リリースは 2022 年 6 月 14 日に発表されたリリースを訳したものです

タワーセミコンダクター、IMS 2022 で RF ファンドリテクノロジーにおける 最近のイノベーションについて発表

同社の経験豊富なエンジニアによる厳選されたプレゼンテーションとワークショップ

イスラエル ミグダル ハエメク、2022 年 6 月 14 日 — 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリである[タワーセミコンダクター](#) (NASDAQ/TASE:TSEM)は、本日、6 月 19 日～24 日にコロラド州 デンバーで開催される 2022 年 IMS カンファレンスへの出展を発表しました。新しいワイヤレスおよび有線 IC のニーズに対応する同社の最近の RF 技術開発について紹介します。これには、ミリ波、成長が期待される Satcom (衛星通信)、データセンター、RF/モバイル向けなど、今後の半導体市場に必要な技術が含まれます。カンファレンスのワークショップでは、同社の経験豊富なエンジニアによって選りすぐりのプレゼンテーションが行われます (下記スケジュール参照)。

タワーセミコンダクターの高度な RF プラットフォームは、ワイヤレス RF からミリ波通信まで、業界をリードする低損失、高ダイナミックレンジ技術を開発・確立し、SiGe BiCMOS、RF-SOI、シリコンフォトニクス、RF-CMOS テクノロジーのソリューションを提供します。これにより、さまざまなコンシューマー機器、インフラ、自動車用アプリケーション向けに、高速、低ノイズ、低消費電力の製品を実現可能にします。トランジスタ速度が 0.5THz に近づいた SBC18H6 SiGe BiCMOS プラットフォームのような同社の最近の RF プラットフォーム開発により、これまでにない帯域幅で、より高速、低電力、低ノイズの RF デバイスを提供します。さらに、世界最高の低記録挿入損失(40GHz まで ~ 0.1 dB)を有する新規の RF スイッチ技術が、現在、RF 製品向けに利用可能であり、新しいモバイルのニーズだけでなく、世界中の 5G ワイヤレスおよび 400~800Gbps 有線システムの急増に対応しています。

プレゼンテーション&ワークショップスケジュール:

Date and Session	Topic	Speaker
June 20, 2022 WMB-4	Foundry Technologies for Satcom and Emerging Commercial Wireless	Dr. David Howard
June 20, 2022 WMC-1	Chalcogenide-Based Phase-Change Material RF Switches: Fundamentals, Design Considerations, and Circuit/System Applications	Dr. Nabil El-Hinnawy
June 20, 2022 WMH-2	Characterizing and Modeling of Safe Operating Area for SiGe NPNs in Tower's SBC18 Technology	Dr. Samir Chaudhry
June 21, 2022 11:30 am Cadence booth #5050	RF and mmWave IC Design Solutions for Cadence tools on Tower's SiGe BiCMOS and RF SOI technologies	Dr. Samir Chaudhry

カンファレンス期間中はタワーのエンジニアリングチームが当社ブースでお待ちしています (booth#4017)

詳しい内容や登録については、[イベントウェブサイト](#)をご覧ください。

当社の RF プラットフォームの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル /CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント (BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点が、イタリアに設立されている 300mm ファブを ST と共有しています。詳細は <http://www.towersemi.com/> をご覧ください。

###

Tower Semiconductor Company Contact: Orit Shahar | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

Tower Semiconductor Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com